

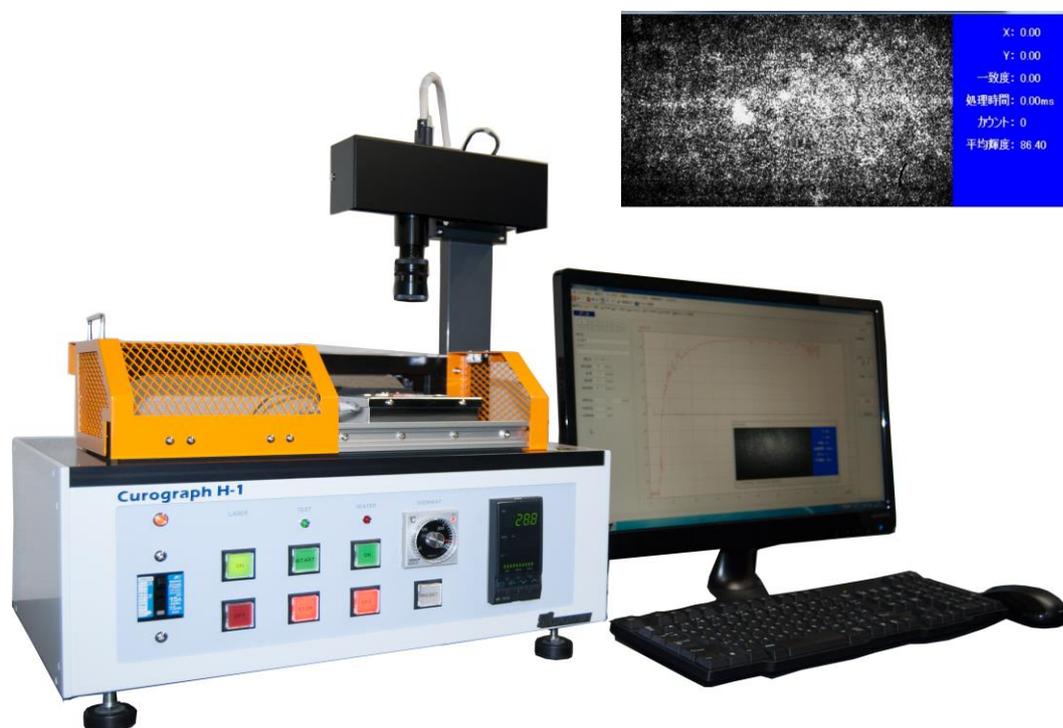
キュアログラフ H-1

Curograph H-1

用 途

非接触 乾燥 硬化時間測定装置

塗料・インキ・接着剤などが乾燥・硬化する時間は、従来接触法により評価されてきました。この装置はレーザー干渉技術を応用した非接触法による測定装置で、試料表面にレーザー光を照射し反射光の中に生ずる斑点状の干渉縞模様を独自の画像処理技術により処理します。これは試料の状態変化を評価する新しい測定法で、乾燥・硬化時間・軟化時間・表皮の乾燥状態などが測定可能で、液体から固体、ゾル状からゲル状への変化など幅広い分野に適応できます。



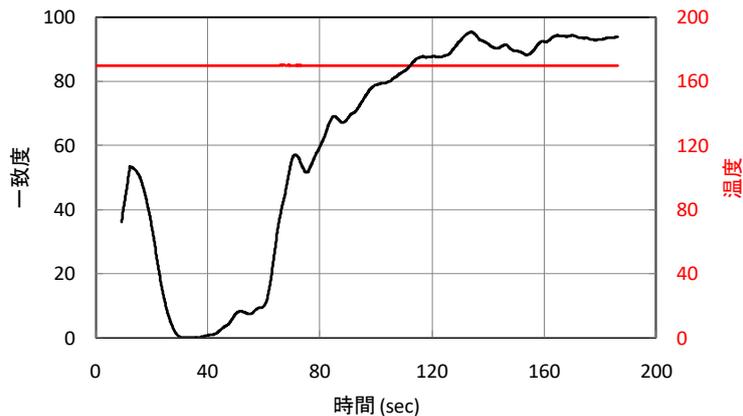
特 長

- 非接触測定のため、試料に負荷をかけず、傷もつけません
- リアルタイム計測しているため、乾燥・硬化の過程をその場で観察可能
- 熱板により試料に温度をかけた状態での測定が可能
- 計測間隔を変えることで速く硬化する材料から長時間で硬化する材料まで測定が可能^{NEW}
- 反射光の明るさをレーザー出力を変えて自動調整することが可能^{NEW}
- 画像を保存し計測間隔を変えた結果を再計算することが可能^{NEW}

仕 様

| | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. 計測時間 | 1分～1200時間 ただし計測間隔によって変わる |
| 2. 計測間隔 | 0.05～120秒 |
| 3. 光源 (レーザー) | 赤色半導体レーザー |
| | 発光波長 640nm クラス 3B |
| | 最大出力 30mW未満 |
| 4. 測定結果 | 乾燥または硬化時間およびその過程 (グラフ) |
| 5. 熱板 | 寸法:150mm×40mm 材質:真鍮 |
| 6. ヒーター容量 | 300W |
| 7. 温度範囲 | 室温 又は 室温+20℃～300℃ (PID制御方式) |
| 8. C-MOSカメラ | モノクロ 2560×2048画素 画素ピッチ5μm |
| 9. データ処理装置 | デスクトップ型パソコン OS Windows |
| | モニタ 20インチ以上,プリンタ |
| 10. 電源 | AC100V 単相 50/60Hz 10A |
| 11. 機体寸法・質量 | 約 W455×D294×H570mm 約20kg |

熱硬化性樹脂の硬化測定(熱板温度170℃)



この装置には半導体レーザーを使用しています。(クラス3B)
 ご使用の際には次の点にご注意願います。
 レーザー光の直接光および反射光を直視しないでください。
 装置を分解しないでください。



材料試験機の総合メーカー 株式会社 **東洋精機** 製作所

本社・東京支店 〒114-8557 東京都北区滝野川5-15-4 TEL 03-3916-8181 FAX 03-3916-8173
 大阪支店 〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-14-35(中央社ビル2F) TEL 06-6386-2851 FAX 06-6330-7438
 名古屋支店 〒461-0003 愛知県名古屋市東区筒井3-30-12(森ビル別館) TEL 052-933-0491 FAX 052-933-0591

<https://www.toyoseiki.co.jp/>